

# Call for Papers

## 30. FED-Konferenz

29. und 30. September 2022

Kongresshotel Potsdam



## Den Wandel gestalten: Design-, Fertigungs- und Managementprozesse für Elektronik optimieren

Das sind die Themen 2022. Reichen Sie Ihren Vortrag ein!

### **PCB-Design: komplex und innovativ**

- Hohe Verdrahtungsdichte (HDI)
- Signal- und Power-Integrität, EMV
- HF- und Radar-Anwendungen
- Tools und Tipps für EDA und Simulation

### **Schaltungsträger: Neue Wege**

- Additive Prozesse und Printed Electronics
- 3D-Elektronik: Materialien, Tools, Prozesse
- Leiterplatten für IoT und 5G
- Embedded Systeme und Systemintegration

### **Baugruppenfertigung: digital und lean**

- Prozessoptimierung und Zuverlässigkeit
- Intelligente Vernetzung für Industrie 4.0
- Virtuelle Fertigung und digitaler Zwilling
- Smart Factory, Augmented Reality und KI
- Lean Production: Ausfallzeiten minimieren, Verfügbarkeit maximieren

### **Arbeitswelt im Wandel: Der Covid Change**

- Neue Arbeitsorganisation: virtuell und agil
- Neue Lern- oder Kommunikationsmethoden
- Im Wettbewerb um Fachkräfte bestehen
- Work-Life-Balance

### **Management: Erfolgsgeschichten**

- Digitale Transformation und Geschäftsmodelle
- Zulassung und Freigabe von Produkten
- Cyber Security: Sichere IT in KMU
- Best Practice in EMS: Bauteilebeschaffung, Obsoleszenz- und Lifecycle-Management

### **Nachhaltigkeit: mehr als Umweltschutz**

- CO<sub>2</sub>-Bilanz: Anforderungen, Fördermittel und Best-Practice-Beispiele für Unternehmen
- Ressourcen schonende Elektronikfertigung
- Vermeidung von Risikostoffen
- Life Cycle Management von Produkten

# Die FED-Konferenz: Die Plattform für die Elektronikindustrie

Die Konferenz des Fachverbandes für Design, Leiterplatten- und Elektronikfertigung (FED) bringt seit 30 Jahren Praktiker und Entscheider aus der Elektronikbranche zum Wissens- und Erfahrungsaustausch zusammen. Sie ist die Plattform, um sich über Prozesse, Lösungen und neue Trends zu informieren und auszutauschen. Das Besondere dabei: Die FED-Konferenz nimmt den gesamten Entwicklungs- und Fertigungsprozess von elektronischen Baugruppen und Geräten in den Fokus. Sie richtet sich an Leiterplattendesigner, Fertigungs- und Projektleiter sowie an Entscheider aus Management und Vertrieb.

Wir laden Sie ein, Ihr Wissen mit unserer Community zu teilen.

**Haben Sie weitere interessante Themen und Vorträge? Reichen Sie sie gerne ein! Eine Programmkommission entscheidet über die Zulassung.**

## Die FED-Konferenz im Überblick

- Thema: der gesamte Entwicklungs- und Fertigungsprozess von elektronischen Baugruppen und Systemen
- Teilnehmer: Entwickler, Leiterplatten- und Baugruppendesigner, Fertigungs- und Projektleiter, technisches Management
- Vorträge und Expertenrunden in vier parallelen Themenblöcken
- mitreißende Keynotes
- Rahmenprogramm zum Netzwerken
- begleitende Fachausstellung

## Der Nutzen für Sie als Redner

- Sie präsentieren Ihr Wissen vor Fachpublikum (ca. 350 Teilnehmer)
- Sie sind am Tag Ihres Vortrages und am Festabend am 29. September unser Gast (exklusiv Hotel)
- Sie besetzen Ihr Thema in der Konferenzdokumentation des FED
- Sie erhalten zusätzlich hohe Aufmerksamkeit für Ihr Thema mit unserer Öffentlichkeitsarbeit in Print- und Online-Medien sowie sozialen Netzwerken

**Einsendeschluss: 25. März 2022**

Bitte reichen Sie Ihren Fachvortrag bis zum 25. März 2022 ein. Die Vortragslänge sollte 35 Minuten nicht überschreiten. Nutzen Sie zum Einreichen Ihres Vortrages bitte das Online-Formular auf unserer Webseite.

[www.fed-konferenz.de/cfp](http://www.fed-konferenz.de/cfp)

## Ihr Ansprechpartner



Thomas Bujotzek  
Referent Technik

Telefon: +49 30 340 6030 55  
E-Mail: [t.bujotzek@fed.de](mailto:t.bujotzek@fed.de)

**FED**

Fachverband für Design,  
Leiterplatten- & Elektronikfertigung